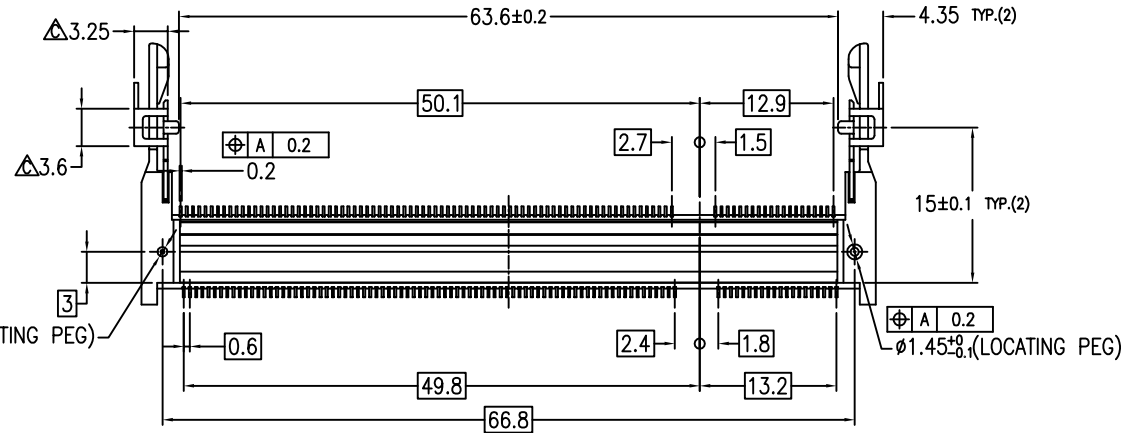
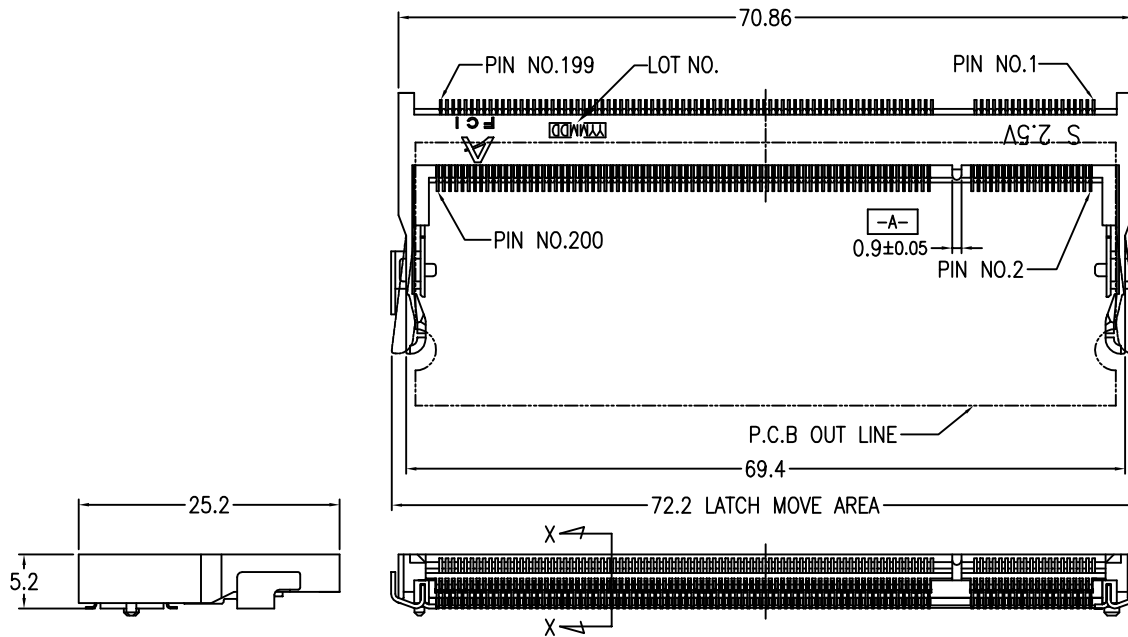


PRODUCT NO.
SEE SHEET 4



NOTE

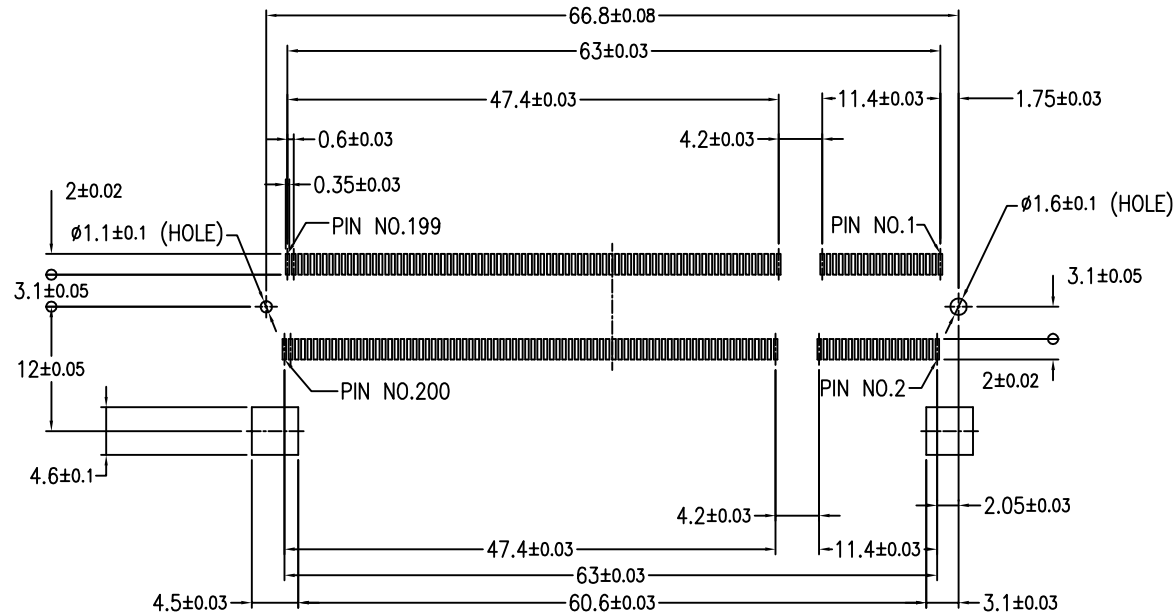
- PRODUCT SPEC. : GS-12-195
- PACKAGING SPEC. : GS-14-786
- MATERIAL
 - HOUSING : LCP, UL94V-0, COLOR BLACK
 - CONTACT : COPPER ALLOY
 - HOLD DOWN : BRASS
- FINISH
 - TERMINAL : SEE TABLE
 - HOLD DOWN : SEE TABLE
- CO-PLANARITY : 0.1 MAX.(INCLUDE HOLD DOWN)
- THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260° PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDER APPLICATION.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date						
G	J04-0132	M.H	04/06/04'	linear	.X ± 0.30	projection	title DDR SO-DIMM 0.6 mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASS'Y		
H	T05-0022	R.C	01/27/05'		.XX ± 0.30				
J	T05-0026	R.C	02/04/05'	angles	0° ± 2°		product family 50UF SO-DIMM size dwg no B 59354		
K	PG05-0388	K.W	10/13/05'	dr	M.Hasegawa 4/6/04	MM			
L	PG08-0333	B.L	12/01/08'	enr	M.Hasegawa 4/6/04	scale	code JP sheet 1 of 4		
				chr		2:1			
				appd					
sheet index	revision sheet	L 1	L 2	L 3	L 4				

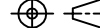


PRODUCT NO.

59354-x52xx

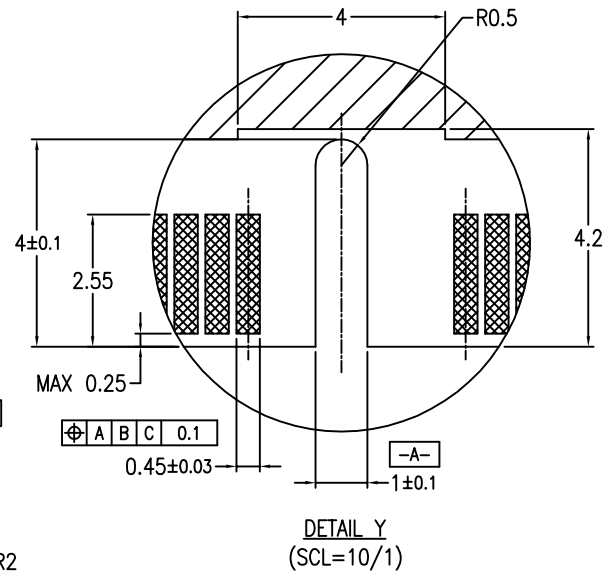
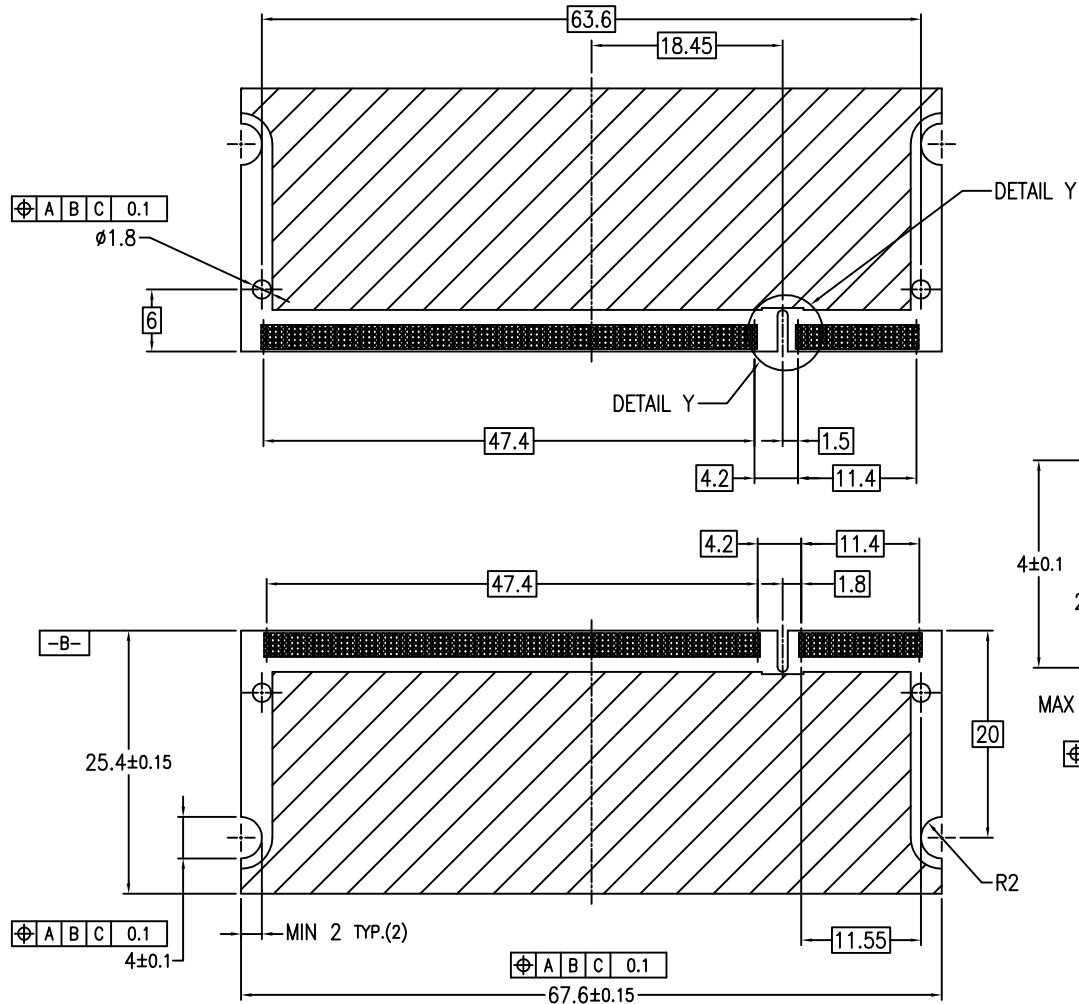
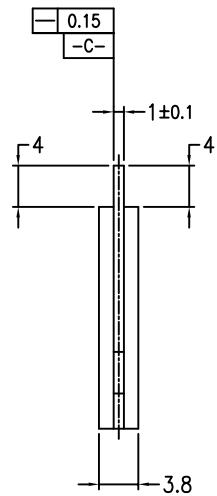


RECOMMENDED MOUNTING P.C.B LAYOUT

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified			CUSTOMER COPY		 www.fciconnect.com											
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.30			projection 	title DDR SO-DIMM 0.6 mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASS'Y											
L					.XX ± 0.30															
				angles	0° ±2°			 scale 2:1	product family 50UF SO-DIMM						code JP					
				dr	M.Hasegawa	11/10/03	size dwg no						sheet 2 of							
				enrg	M.Hasegawa	11/10/03														
				chr																
				appd																
sheet index	revision sheet																			



PRODUCT NO.
59354-x52xx



RECOMMENDED MODULE P.C.B. LAYOUT

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	 www.fciconnect.com		
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.30 .XX ± 0.30				
L				angles	0° ±2°	projection	 title DDR SO-DIMM 0.6 mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASS'Y		
				dr	M.Hasegawa 11/10/03	MM			
				enr	M.Hasegawa 11/10/03	scale	product family 50UF SO-DIMM size dwg no B 59354		
				chr		2:1			
				appd			code JP sheet 3 of		
sheet index	revision sheet								



PRODUCT NO.	LOCATING PEG	TERMINAL CONTACT AREA FINISH	HOLD DOWN FINISH	SOLDER TAIL FINISH
59354-052FS	YES	Au FLASH	Pure Sn PLATING	Au FLASH PLATING
59354-152FS	NO			
59354-052TS	YES	Au 0.3μm MIN.		
59354-152TS	NO			
59354-052AS	YES	Au 0.76μm MIN.		
59354-152AS	NO			
59354-052FC	YES	Au FLASH	Sn-Cu PLATING	
59354-152FC	NO			
59354-052TC	YES	Au 0.3μm MIN.		
59354-152TC	NO			
59354-052AC	YES	Au 0.76μm MIN.		
59354-152AC	NO			
59354-252FS	YES	Au FLASH	Pure Sn PLATING	Pure Sn PLATING
59354-352FS	NO			
59354-252TS	YES	Au 0.3μm MIN.		
59354-352TS	NO			
59354-252AS	YES	Au 0.76μm MIN.		
59354-352AS	NO			
59354-252FC	YES	Au FLASH	Sn-Cu PLATING	
59354-352FC	NO			
59354-252TC	YES	Au 0.3μm MIN.		
59354-352TC	NO			
59354-252AC	YES	Au 0.76μm MIN.		
59354-352AC	NO			

PRODUCT NO.	LOCATING PEG	TERMINAL CONTACT AREA FINISH	HOLD DOWN FINISH	SOLDER TAIL FINISH
59354-452FS	YES	Au FLASH	Pure Sn PLATING	Sn-Pb PLATING
59354-552FS	NO			
59354-452TS	YES	Au 0.3μm MIN.		
59354-552TS	NO			
59354-452AS	YES	Au 0.76μm MIN.		
59354-552AS	NO			
59354-452FC	YES	Au FLASH	Sn-Cu PLATING	
59354-552FC	NO			
59354-452TC	YES	Au 0.3μm MIN.		
59354-552TC	NO			
59354-452AC	YES	Au 0.76μm MIN.		
59354-552AC	NO			

△ 59354-□□□□□ LF

<PACKING METHOD>

R : TAPE REEL
DEFAULT : TRAY

<HOLD DOWN FINISH>

S : Pure Sn
B : Sn-Pb

<CONTACT AREA FINISH>

F : Au FLASH
T : Au 0.3μm MIN.
A : Au 0.76μm MIN.

<TOTAL HEIGHT>

52 : 5.2mm

<LOCATING PEG, SOLDER TAIL FINISH>

0 : YES, Au FLASH
1 : NO, Au FLASH
2 : YES, Pure Sn PLATING
3 : NO, Pure Sn PLATING
4 : YES, Sn-Pb PLATING
5 : NO, Sn-Pb PLATING

For Rohs OPTIONS:
TAIL PLATING CODE MUST BE 0~3.
HOLD DOWN PLATING CODE MUST BE "S".
"LF" CODE IS EXIST IN THE END.
EX: 59354-252TSLF

FOR NOT Rohs COMPATIBLE:
THIS "LF" CODE IS "BLANK".
EX:59354-452TS

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI			
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.30 .XX ± 0.30		www.fciconnect.com			
L				linear		projection	title			
				angles	0° ±2°		DDR SO-DIMM 0.6 mm PITCH 200 POS. STANDARD TYPE ASS'Y			
				dr	M.Hasegawa 4/6/04	MM	product family 50UF SO-DIMM		code JP	
				engr	M.Hasegawa 4/6/04	scale	size dwg no		sheet 4 of	
				chr		2:1	B 59354			
				appd						
sheet index	revision sheet									

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9